

令和4年6月24日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
定例講演会  
会長 嶋田 勇三

## 第215回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第215回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。また、今回は、年度初めということもあり、講演前に総会を行います。総会出席を予定されている会員の皆様におきましては、ご参加いただけますようよろしくお願いいたします。

今回も新型コロナウイルス感染症対策のため、WEB会議システム（zoom ウェビナー）を利用した開催となります。会場開催での定例講演会と申込内容や開催形式が異なりますので、ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

ご多忙の中恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページやFacebookでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

### 記

1. 開催日時：令和4年7月21日（木）定例講演会 13：20～16：50

2. 開催方式：WEB会議システム「zoom ウェビナー」  
(参加申し込みをされた方に後日、招待メールをお送りします)

3. プログラム：“**光半導体、光電融合。次世代に向けた最新動向と関連技術**”

13:20～14:20 プログラムテーマ①	『光電コパッケージ技術の現状と将来展望』 国立研究開発法人産業技術総合研究所 プラットフォームフォトンクス研究センター 研究チーム長 天野 建 氏 講演内容：データセンタやスーパーコンピュータなどの実効性能向上へ向けて、機器内外のデータ伝送の広帯域化、低消費電力化が求められている。このような要求に対して、電気ケーブルから光ケーブルの採用が進められている。今後はより広帯域な信号伝送が必要になっており、電気配線の短尺化を可能とする次世代実装形態として、光電信号素子を電子素子と同一パッケージ上に集積する光電コパッケージ実装技術が世界中で検討されている。本講演では光電コパッケージ技術の世界的な動向を紹介する。また、日本の光電コパッケージ技術の取り組み（NEDO 光エレ実装プロジェクト：技術研究組合 PETRA）に関して最新データを交えて紹介する。
14:20～15:20 プログラムテーマ②	『Beyond5G に向けたテラヘルツ・フォトンクス融合ネットワークの研究動向』 早稲田大学 理工学術院基幹理工学部 電子物理システム学科 教授 川西 哲也氏 講演内容：5G のサービスがはじまったばかりだが、すでに Beyond5G や 6G に向けた議論が本格化している。Beyond5G/6G では Tbps 級超高速伝送をどこでも、何にでもつながるといった機能が期待されています。必要な基地局数が莫大になるため多数の基地局間をつなぐネットワークを効率よく整備することが重要となる。光ファイバ通信は長距離通信から、データセンタ内やチップ間通信など応用範囲を広げている。一方、無線通信はその柔軟性から利用が拡大しているが、既存の電波帯域はすでに様々なサービスに用いられており、周波数資源の逼迫が課題です。テラヘルツ帯までを含む多種多様な伝送メディアを融合するための技術を、ハードウェア・モノづくりの視点から取り上げてみる。
15:20～15:40	— 休憩 —
15:40～16:40 プログラムテーマ③	『近赤外光硬化性樹脂を用いた光デバイス自動接続への展開』 宇都宮大学 工学部/(兼担) オプティクス教育研究センター 教授 杉原 興浩 氏 講演内容：データ伝送の増大に伴い、光通信や光インターコネクション分野が高性能化している。これらの分野においては、光デバイス間を簡便低損失に接続する実装技術が必要とな

	り、自動接続の実現によって分野の発展に大きく貢献できる。 本講演では、自己形成光導波路接続技術に着目し、これらの光デバイス間の自動接続に必要な赤外光硬化性樹脂の開発と、光通信デバイス、シリコンフォトニクスデバイスの接続の事例と将来展望について紹介する。
16：40～16：50	『トークセッション』 講師の皆様と参加者の皆様とで、意見交換を行う時間を設けます。

#### 4. 参加費

**会 員：無料** 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。

**会員外：22,000円/人**（お申し込み後、請求書をお送りします）

5. 参加申し込み：会員のご出欠については、会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

会員外の方は、ホームページのお問い合わせフォーム

（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に第215回に定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和4年7月13日（水）

会員外 令和4年7月6日（水）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日1週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、ご参加者（企業正会員は登録代表者（連絡担当者））に講演日1週間前に郵便で発送させていただきます。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田  
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)

E-mail: [j.jisso.org@gmail.com](mailto:j.jisso.org@gmail.com)

URL : <http://www.j-jisso.org/index.html>